



Fig.1 Three-dimensional view of CSTBT.

An wen richtet sich das Seminar?

Die aktuelle Chip-Technologie (CSTBT) von Mitsubishi stellt eine Verbesserung der Eigenschaften und der Einsatzgebiete für IGBTs dar. Seit Einführung der CSTBT-Chips hat Mitsubishi verschiedene Modulserien optimiert auf bestimmte Anwendungsbereiche entwickelt. In dem Seminar werden die Möglichkeiten dieser Technologie aufgezeigt und Auswirkungen auf bestehende und neue Anwendungsgebiete besprochen.

Daher richtet sich dieses Seminar sowohl an Entwickler, die bereits mit IGBT-Modulen arbeiten, als auch an jene, die auf diesem Gebiet anfangen wollen.

Wo findet das Seminar statt?

Radisson SAS Hotel – Marseiller Str. 2 – 20355 Hamburg (Nähe Bahnhof Hamburg-Dammtor)

Wann findet das Seminar statt?

Dienstag, 21. November 2006, 9:00 Uhr – 17:00 Uhr

Einen genauen Ablauf können Sie der Agenda auf der folgenden Seite entnehmen.

Was kostet das Seminar und was bekommen Sie dafür?

Für die Teilnahme am Seminar berechnen wir eine Gebühr von **75,- € (inkl. UST)**.

Der Betrag wird mit der Bestätigung Ihrer verbindlichen Anmeldung fällig.

In der Seminargebühr sind Essen und Getränke während des Seminars enthalten.

Außerdem erhalten Sie ausführliche Seminarunterlagen zu den präsentierten Themen.

Jeder Teilnehmer bekommt einen Gutschein über 50,- €, den Sie bei Ihrer nächsten Rechnung über Mitsubishi Module abziehen können.

Technisches Seminar von Mitsubishi

**Dienstag,
21. November 2006
9:00 Uhr bis 17:00 Uhr**

Referenten: Applikationsingenieure, Mitsubishi Electric

Zeitlicher Ablauf:

9:00 Uhr	Begrüßung der Teilnehmer
9:10 Uhr	Start der technischen Präsentationen
10:45 Uhr	Kaffeepause
11:05 Uhr	Technische Präsentationen
12:30 Uhr	Mittagessen
13:15 Uhr	Technische Präsentationen
14:45 Uhr	Kaffeepause
15:00 Uhr	Technische Präsentationen
16:30 Uhr	Fragen und Diskussion

Themen der technischen Präsentationen:

1. **CSTBT Chip Technology**
2. **5th Generation IGBT-Modules**
 - 2.1 A-Series (kostenoptimierte Module)
 - 2.2 NF-Series (Module für niedrige Schaltfrequenz)
 - 2.3 Mega Power Dual Modules
3. **5th Generation Intelligent Power Modules (IPM)**
 - 3.1 L-Series
4. **New 1700V A-Series**
5. **New 1200V NFH & NFM-Series**
(Module für höhere Schaltfrequenzen)
6. **Melco-Sim (Vers. 2) mit Berechnungsbeispiel**
(Einführung in das Simulationsprogramm von Mitsubishi)
7. **Transfer Mold IPM Family**
8. **New Mini-DIP-IPM 3A/600V**
9. **DIP-CIB & Demo-board**
10. **HVIC**
for Motor Control, Lighting, DC-DC Conversion

Die Präsentationen werden in deutscher Sprache gehalten !

